



## 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成25年10月30日

上場会社名 株式会社 エンプラス 上場取引所 東  
 コード番号 6961 URL http://www.enplas.com  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 横田 大輔  
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営企画管理本部 (氏名) 星野 清孝 TEL 048-253-3131  
 グループサービスセンター長  
 四半期報告書提出予定日 平成25年11月8日 配当支払開始予定日 平成25年12月2日  
 四半期決算補足説明資料作成の有無： 有  
 四半期決算説明会開催の有無： 有 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第2四半期	20,154	61.4	6,498	208.7	6,743	224.0	5,227	223.3
25年3月期第2四半期	12,486	30.7	2,105	988.4	2,081	987.7	1,617	—

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 5,528百万円 (394.4%) 25年3月期第2四半期 1,118百万円 (-%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第2四半期	361.26	355.86
25年3月期第2四半期	114.77	113.18

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
26年3月期第2四半期	44,717	39,174	87.4	2,686.04
25年3月期	38,661	33,645	86.6	2,328.03

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 39,071百万円 25年3月期 33,486百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	20.00	—	20.00	40.00
26年3月期	—	30.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	30.00	60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

配当予想の修正については、本日（平成25年10月30日）公表いたしました「剰余金の配当（中間配当）および期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

### 3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	40,000	52.4	13,000	185.4	13,000	163.6	9,500	68.6	653.09

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：有  
新規 1社 （社名）Enplas Semiconductor Peripherals Pte. Ltd.  
除外 1社 （社名）－

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	26年3月期2Q	20,232,897株	25年3月期	20,232,897株
② 期末自己株式数	26年3月期2Q	5,686,703株	25年3月期	5,848,946株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	26年3月期2Q	14,470,238株	25年3月期2Q	14,089,698株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）

当社は、平成25年10月30日（水）に機関投資家及びアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する四半期決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	4
3. 四半期連結財務諸表 .....	5
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	7
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	7
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	9
(継続企業の前提に関する注記) .....	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	9
(重要な後発事象) .....	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、欧州危機に代わって、新興国において、景気減速と米国金融緩和の出口をめぐる金融市場の混乱というリスクが顕在化しました。インドネシア、タイなどで景気をけん引してきた国内消費が減速、中国においても外需の低迷による輸出の鈍化と内需の伸び悩みに起因する企業活動の停滞が見られました。米国経済は、内需は底堅いものの新興国や欧州などの海外市場の減速、及び国内財政問題で予断を許さない状況が続いております。

わが国経済は、政府、日銀の政策効果、円安、株高により、個人消費と輸出が好調に推移し、各種経済指標の改善により景気の回復基調を確認する結果となりました。

当社グループが関連する電子部品業界におきましては、半導体関連は米国、アジアを中心に市場の安定的な成長が見られ、レーザープリンタ関連は、台数ベースではプラス成長に転じたものの金額ベースでは引き続きマイナス成長となりました。LED光源液晶テレビは、新興国市場での成長が続き、低コスト化のニーズは益々高まりました。

このような状況の中、当社グループは、基幹事業であるエンブラ事業は収益性の向上、成長市場であるアジアでの受注強化、半導体機器事業は新しいソリューションの創出、グローバル顧客サポート体制の拡充、オプト事業ではLED用拡散レンズの拡販によるディスプレイ業界における確固たる地位の確立を目指すべく、①新製品・新領域への挑戦による成長の実現 ②強い事業、持続可能な事業の裏付けとなる要素技術及び技術理論の確立を目指した先端技術の追求 ③グローバルベースでの迅速で効果的な経営判断を可能とするグローバル経営基盤の強化を今期の経営課題と捉え積極的に取り組んでまいりました。

特に、半導体機器事業においては、グローバル競争が激化する中、顧客である半導体メーカーの量産拠点が集中する東南アジア、中国、台湾の事業上の位置付けがより重要となってきております。市場の中心で顧客のニーズを的確に掴み、顧客価値を増大するソリューションを市場の中心から顧客に提供できる体制を構築するために、シンガポールに当社100%出資の子会社を設立し、当社国内子会社の株式会社エンプラス半導体機器の有する半導体機器事業の本社機能を移管することとしました。また、半導体機器事業本社のシンガポール移転に合わせ、半導体機器事業の更なる拡大を目的とし、フィリピンにシンガポール新会社100%出資の現地法人を設立することを決定しました。

この結果、当第2四半期の連結売上高は20,154百万円（前年同期比61.4%増）となり、収益面におきましても、連結営業利益は6,498百万円（前年同期比208.7%増）、連結経常利益は6,743百万円（前年同期比224.0%増）となり、連結四半期純利益は5,227百万円（前年同期比223.3%増）となりました。

各セグメントの業績は次のとおりであります。

#### 「エンブラ事業」

当社主力製品であるプリンター用部品が低調に推移する一方、自動車用部品は、米国での自動車販売増加の影響を受け好調に推移しました。受注増加により操業度が向上したこともあり、当第2四半期の連結売上高は6,126百万円（前年同期比11.8%増）、セグメント営業利益は、47百万円（前年同期は77百万円のセグメント営業損失）となりました。

#### 「半導体機器事業」

車載、CPU向けバーンインソケットが引き続き好調に推移しました。継続的な海外調達拡大と円安効果による原価低減も加わり、当第2四半期の連結売上高は3,261百万円（前年同期比23.0%増）、セグメント営業利益は552百万円（前年同期比103.8%増）となりました。

#### 「オプト事業」

主力のLED用拡散レンズは、引き続き、LED光源液晶テレビの中でもコストメリットのある光源直下型タイプの採用が進んだことにより、当社レンズの販売も増加いたしました。この結果、当第2四半期の連結売上高は10,767百万円（前年同期比147.3%増）、セグメント営業利益は5,898百万円（前年同期比208.5%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産、負債及び純資産の状況)

当第2四半期連結会計期間末における総資産は44,717百万円となり、前連結会計年度末比6,055百万円の増加となりました。流動資産につきましては5,084百万円増加しました。主な変動要因はその他流動資産で963百万円、受取手形及び売掛金で403百万円減少したものの、現金及び預金で6,125百万円、有価証券で300百万円増加したことによるものです。固定資産につきましては971百万円増加しました。主な変動要因は有形固定資産で291百万円減少したものの、投資その他の資産で1,240百万円増加したことによるものです。

負債は5,543百万円となり、前連結会計年度末比で527百万円の増加となりました。流動負債につきましては610百万円増加しました。主な変動要因は買掛金が402百万円減少したものの、未払法人税等が940百万円増加したことによるものです。固定負債につきましては83百万円減少しました。主な変動要因はその他固定負債で12百万円増加したものの、長期借入金で99百万円減少したことによるものです。

純資産は39,174百万円となり、前連結会計年度末比5,528百万円の増加となりました。主な変動要因は利益剰余金で4,939百万円、為替換算調整勘定で239百万円、自己株式で229百万円、資本剰余金で118百万円増加したことによるものです。その結果、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は87.4%となり、前連結会計年度末比で0.8%増加しております。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年7月30日に公表しました連結業績予想から修正は行っておりません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当第2四半期連結累計期間において、Enplas Semiconductor Peripherals Pte. Ltd.を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	13,388,873	19,514,517
受取手形及び売掛金	6,267,226	5,863,904
有価証券	2,999,973	3,299,998
製品	609,385	750,953
仕掛品	619,655	464,730
原材料及び貯蔵品	583,387	621,316
その他	2,705,454	1,741,556
貸倒引当金	△7,210	△5,527
流動資産合計	27,166,745	32,251,450
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,533,947	3,483,924
機械装置及び運搬具（純額）	2,572,232	2,675,079
土地	2,692,924	2,694,403
その他（純額）	1,444,558	1,099,065
有形固定資産合計	10,243,663	9,952,473
無形固定資産		
ソフトウェア	492,505	498,405
その他	59,472	75,021
無形固定資産合計	551,977	573,427
投資その他の資産	699,082	1,939,963
固定資産合計	11,494,723	12,465,864
資産合計	38,661,469	44,717,314

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	1,560,338	1,157,815
1年内返済予定の長期借入金	199,992	199,992
未払法人税等	645,004	1,585,324
賞与引当金	422,432	594,750
役員賞与引当金	135,749	125,120
その他	1,496,161	1,407,535
流動負債合計	4,459,678	5,070,539
固定負債		
長期借入金	500,020	400,024
退職給付引当金	10,425	12,179
役員退職慰労引当金	14,677	16,894
その他	31,458	43,633
固定負債合計	556,581	472,731
負債合計	5,016,259	5,543,270
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	8,080,454	8,080,454
資本剰余金	10,190,269	10,309,138
利益剰余金	24,069,974	29,009,756
自己株式	△8,361,816	△8,131,997
株主資本合計	33,978,882	39,267,351
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	53,583	111,243
為替換算調整勘定	△546,152	△306,878
その他の包括利益累計額合計	△492,568	△195,635
新株予約権	132,664	73,326
少数株主持分	26,231	29,001
純資産合計	33,645,209	39,174,043
負債純資産合計	38,661,469	44,717,314



(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
売上高	12,486,261	20,154,989
売上原価	7,120,984	9,378,474
売上総利益	5,365,277	10,776,514
販売費及び一般管理費	3,259,762	4,277,722
営業利益	2,105,515	6,498,791
営業外収益		
受取利息	14,503	13,080
受取配当金	7,000	7,177
為替差益	—	113,721
スクラップ売却益	46,883	94,322
その他	32,977	36,988
営業外収益合計	101,364	265,290
営業外費用		
為替差損	90,989	—
固定資産賃貸費用	11,365	16,559
その他	23,366	4,278
営業外費用合計	125,721	20,838
経常利益	2,081,158	6,743,243
特別利益		
固定資産売却益	4,123	13,876
新株予約権戻入益	1,694	—
特別利益合計	5,817	13,876
特別損失		
投資有価証券評価損	35,285	—
事業再構築費用	6,290	—
固定資産売却損	1,227	2,669
特別損失合計	42,802	2,669
税金等調整前四半期純利益	2,044,173	6,754,450
法人税、住民税及び事業税	472,356	1,884,978
法人税等調整額	△46,714	△360,711
法人税等合計	425,642	1,524,267
少数株主損益調整前四半期純利益	1,618,531	5,230,183
少数株主利益	1,394	2,723
四半期純利益	1,617,137	5,227,460

(四半期連結包括利益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,618,531	5,230,183
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△32,364	57,659
為替換算調整勘定	△467,869	240,760
その他の包括利益合計	△500,234	298,420
四半期包括利益	1,118,297	5,528,603
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,118,004	5,524,393
少数株主に係る四半期包括利益	292	4,210

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

子会社株式の譲渡

当社は平成25年8月9日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付にて当社の連結子会社である株式会社エンプラス半導体機器の全株式を当社100%出資の子会社Enplas Semiconductor Peripherals Pte. Ltd.に現物出資にて譲渡いたしました。

(1) 株式譲渡の理由

当社半導体機器事業において、グローバル競争に勝ち抜くため、市場の中心で顧客のニーズを的確に掴み、顧客価値を増大するソリューションを市場の中心から顧客に提供できる体制を構築するため。

(2) 株式譲渡の方法

現物出資による。

(3) 譲渡する子会社の概要

名称	株式会社エンプラス半導体機器
事業の内容	半導体機器事業製品の製造、販売

(4) 譲渡する内容

譲渡する株式数	6,200株
譲渡価額	1,100万米ドル
譲渡後の持分比率	0% (間接保有100%)

(5) 実施する会計処理の概要

「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)に基づき、会計処理いたします。

子会社の設立

当社は、平成25年10月30日開催の取締役会において、新たに米国西海岸に子会社を設立することを決議しました。

(1) 子会社設立の目的

新規ビジネス及び新規顧客の獲得による事業拡大を図るとともに、最先端の技術情報の収集を行い、本社と連携し研究開発機能を強化することを目的として、バイオ、光通信関連の有力顧客が集中する米国西海岸に新会社を設立することといたしました。

(2) 子会社の概要

①名称	Enplas Microtech, Inc.
②事業内容	バイオ及び光通信関連製品の販売と研究開発
③資本金	100万米ドル
④出資比率	当社100%
⑤設立年月	平成25年12月 (予定)